

C-300-MCU-T-H・C-300-MCU-M-H

銅製



耐熱導電性マスキングテープ

HEAT-RESISTANT SHIELDING TAPES (masking)

特徴 Feature

- 粉体塗装などの炉内温度が高温時に使用できます。
 - マスキングテープ付の錫めっき銅箔です。
 - 筐体への導電処理(めっき・導電塗装)が省略できます。
 - 塗装後、マスキングテープは簡単に錫めっき銅箔表面から剥がすことができます。
 - マスキングテープ剥離後の錫めっき銅箔表面は導電面として使用できます。
 - 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
 - 加工・貼付け作業が容易に行えます。
- Can be used when applying a powder coating, etc. in a high-temperature compartment.
 - Tin-plated copper foil with masking tape.
 - Saves you the trouble of applying conductivity treatments (plating or conductive coating) to a casing or housing.
 - Following application, simply peel the masking tape away from the tin-plated copper foil surface.
 - After masking tape removal, the tin-plated copper foil can be used as a conducting surface.
 - Uses electrically conductive adhesive to minimize any shielding effect.
 - Easy handling and application.

仕様 ● 1巻30m

用途 ● 筐体のグラウンディングとシールドイング
● 塗装時のマスキングと筐体の防食

納期 ● 標準品・・・納期お問合せください。

備考 ● 切断加工品、異形加工品の製作もできます。

Specifications ● One roll: 30m

Specific-use ● Grounding/shielding for cases/housings

● Masks during painting and prevents casing corrosion.

Remarks ● Can also be made as a cut product and in irregular shapes.

特性 Characteristics

項目 Item	数値 Value
マスキングテープ厚さ(μm) Masking tape thickness	25
マスキングテープのり厚さ(μm) Peel-off glue thickness	25
錫めっき銅箔厚さ(μm) Tin-plated copper foil thickness	52
アクリル系粘着層厚さ(μm) Acrylic adhesive layer thickness	40
製品厚さ(μm) Product thickness	142
マスキングテープ接着力 180° ピール 対錫めっき銅箔(N/25mm) Adhesive strength	初期値 Initial value 1.7 220℃・20分加熱後 After 220℃ heating for 20minutes (2.0)
アクリル系粘着剤接着力 180° ピール 対SUS(N/25mm) Adhesive strength	初期値 Initial value 15.5 220℃・20分加熱後 After 220℃ heating for 20minutes 以上
接触抵抗値(Ω/13mm ² /19.6N) Contact resistance	初期値 Initial value 0.001 220℃・20分加熱後 After 220℃ heating for 20minutes 以下
使用温度範囲(℃) Usable temperature range	-40 ~+80

特徴 Feature

- 特性はC-300-MCU-T-Hと同じです。
- Characteristics are the same as for C-300-MCU-T-H.

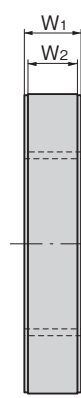
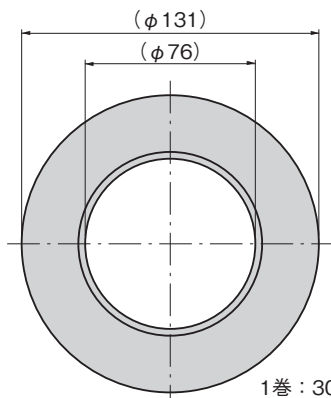
仕様 ● 1シート10枚入

納期 ● 標準在庫品

Specifications ● One sheet: 10pcs

商品番号 Product No.	RoHS 10+	備考 Remarks	φd	φD	(L)	製品質量(g) Mass	コード Code
C-300-MCU-M4-H	●	M4用 For M4	4.3	15	180	1.0	24539
C-300-MCU-M5-H	●	M5用 For M5	5.3	15	180	0.95	24540
C-300-MCU-M6-H	●	M6用 For M6	6.3	17	200	1.31	24541
C-300-MCU-M8-H	●	M8用 For M8	8.3	19	200	1.42	24542

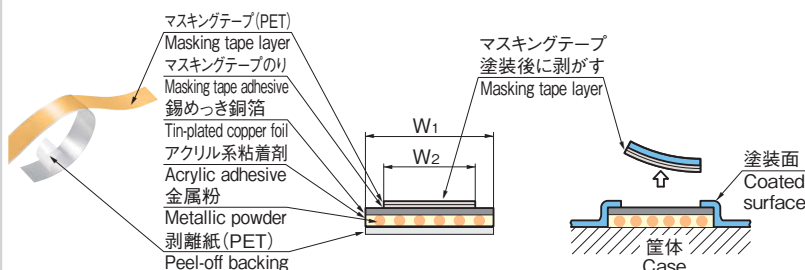
●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。



C-300-MCU-T25-H

構造 Construction

マスキングテープは製品に貼付けされており、簡単に剥がれます。
Masking tape is adhered to the product, and can be peeled away easily.



使用方法 Application method

1. 接着面の汚れや油分を落とし、剥離紙を剥がしながらC-300-MCU-T-Hを貼付けます。
1. Remove any grime and oil from contact surface, then adhere C-300-MCU-T-H while peeling the backing.
2. コーナーは、最初に貼付けたC-300-MCU-T-Hとマスキングテープの間に挟みます。
2. Place corner between C-300-MCU-T-H adhered first and masking tape.
3. ヘラなどでしっかりと押付け、塗装します。
3. Press firmly with a putty knife, etc. and coat.
4. 塗装後、マスキングテープを剥がします。
4. After coating, remove masking tape.

商品番号 Product No.	RoHS 10+	W ₁	W ₂	製品質量(g) Mass	コード Code
C-300-MCU-T13-H	●	13	9.8	286	24538
C-300-MCU-T25-H	●	25	21.8	550	24537

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。



C-300-MCU-M4-H

ワッシャータイプ Washer format

